

株式会社フジミインコーポレーテッド 株主通信

FUJIMI TODAY

2015.4.1~2016.3.31

vol.

42

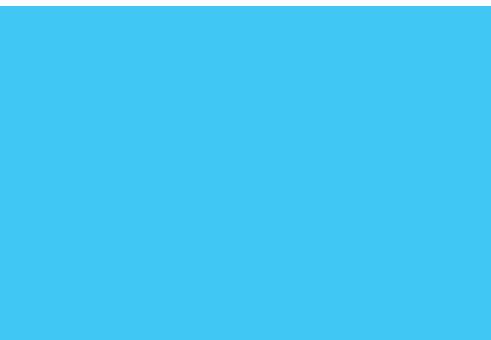
2016年6月発行

特集 フジミの製品が使用されるシーン

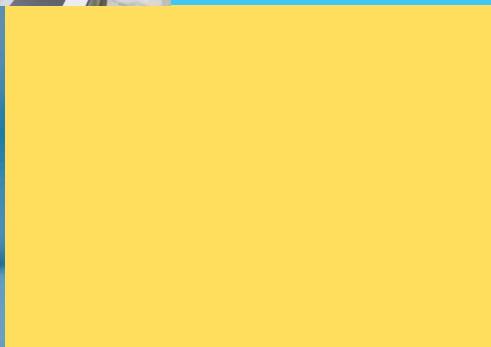
技術を磨き、心をつなぐ

証券コード 5384

FUJIMI



お客様目線の実践
革新への挑戦
新規事業・新規用途開拓の強化



技術を磨き、心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとした
さまざまな産業で活かされています。
フジミはお客様にあらゆる製品を
磨いていただくことで、
人々が快適に暮らせる未来の創造に
貢献します。

代表取締役社長 関 敬史



株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2016年3月期の当社グループを取り巻く環境は、米国では景気回復基調が続き、欧州、日本など先進国は金融緩和と政策などが景気を下支えしましたが、中国をはじめとする新興国は経済成長の鈍化が鮮明となりました。また、世界半導体市場は、これまで成長を牽引してきた中国スマートフォン市場の減速により、第2四半期連結会計期間以降、前年同期を下回る状況となりました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めましたが、当連結会計年度の業績は、売上高 31,755 百万円（前期比 3.2%減）、営業利益は売上減少に加え販売費及び一般管理費の増加により 3,302 百万円（前期比 20.0%減）、経常利益 3,342 百万円（前期比 27.3%減）、親会社株主に帰属する当期純利益 2,346 百万円（前期比 36.5%減）となりました。

2016年3月期のトピックスとしましては、CMP向け製品の売上高が 10,980 百万円となり、過去最高を記録しました。これは、アジア地域における最先端ロジックデバイス向け製品およびメモリデバイス向け製品の販売が好調に推移したことによるものです。現在、フジミ台湾において、次世代向け製品の製造ライン拡張を進めており、更なる売上の伸長を目指してまいります。また、北米においては、米国インテル社より2年連続となるプリファード・クオリティー・サプライヤー

(PQS) 賞*(4Pに記載)を受賞しました。北米においても最先端ロジックデバイス向け製品で高い評価をいただいております、更なる売上拡大に取り組んでまいります。

その他、新たな取組みとしましては、昨年4月に設置しました先端技術研究所の設置に続き、11月にはコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)ファンドを設立しました。既に数多くのベンチャー企業と接触を行い、中長期的な視点に立って独自技術を保有するベンチャー企業への具体的な投資の検討を進めております。今後、当社コア技術とのシナジーが期待でき、新規事業機会の探索活動を加速してまいります。

最後になりますが、現在、第6次となる中長期経営計画を策定中です。本来であれば、当期は2009年6月に策定した中長期経営計画の第3段階にあたりますが、計画の前提となる市場環境および世界経済環境が大きく変化したことから、次なる成長を遂げるために計画の見直しを行っているものです。これまで築き上げた強固な財務基盤を背景として、成長のための既存・新規分野及び当社コア技術の強化と新技術獲得へ向けた投資を積極的に行くと同時に株主の皆様への還元強化、CSR活動にも力を注いでまいります。具体的な取組みでは、株主の皆様への還元強化策として、目標とする連結配当性向をこれまでの30%から2019年3月期を目途に50%まで高めることといたしました。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援をいただきますようお願い申し上げます。

連結決算ハイライト

※2017年3月期は、2016年5月10日現在の予想値です。

■売上高



■営業利益・営業利益率

折れ線グラフ: 営業利益率 (右軸)



■親会社株主に帰属する当期純利益・ROE

折れ線グラフ: ROE (右軸)



特集

フジミの製品が 使用されるシーン

今回は、普段目に触れることのないフジミの製品が、どのような最終製品づくりに利用され、皆様の生活に役立っているのかについて、イラスト等を利用しながらご紹介いたします。



フジミはパソコン・スマホ等に使用されている電子部品、デジタルカメラやメガネのレンズ、自動車等のボディの表面加工に使われる精密研磨材等を製造・販売しています。

フジミの研磨材と先端技術との出会いは1957年にさかのぼります。東京通信工業（現ソニー）にトランジスタラジオ製造用ゲルマニウム半導体基板を磨く研磨材を供給したのが始まりです。その後、半導体基板の材料がシリコンに替わり、加工が進化を遂げる中で、常にお客様目線で最先端の技術に対応するさまざまな研磨材を供給し続けてまいりました。

現在、フジミの精密研磨材は、半導体シリコンウェハ製造工程で使用されるラッピング材*で約80%、ファイナルポリシング材*で約90%の世界シェアを占めています。

マイクロ(100万分の1)メートルやナノ(10億分の1)メートルの精度が求められる半導体集積回路の配線では、基板となるシリコンウェハの表面にわずかな凹凸や傷があっても断線につながります。例えば、直径300mmのウェハで要求される平坦度を野球場に置き換えて言えば、グラウンド全体の高低差で0.02mmの凹凸があってもゆるされないレベルの平坦度になります。



ラッピング材(研磨材)



ポリシング材(鏡面仕上材)*

研磨材に求められる品質の例

【直径】
野球場はシリコンウェハの
約400倍



ラッピング材

シリコン基板等を粗磨きするための粉末研磨材。

ポリシング材(鏡面仕上材)

ラッピング材よりもさらに細かな砥粒と薬液を配合した鏡面仕上げ用の研磨スラリー(液体研磨材)。

ファイナルポリシング材

数ステップの鏡面研磨工程における最終工程で使用される研磨スラリー(液体研磨材)。

フジミのコア技術と製品展開

フジミのコア技術と製品展開

フジミには「ろ過・分級・精製」、「パウダー」、「ケミカル」をキーワードとするコア技術があります。「ろ過・分級・精製技術」とは、粒子を均一にしたり、粗大粒子を除去する技術を指します。「パウダー技術」とは、用途に合わせた粒子の選定、形状制御及び評価を行う技術を指し、ミクロン単位での粒子制御が可能です。「ケミカル技術」とは、分散・溶解・反応・表面保護等の機能を持つ薬液を設計・配合・選定する技術を指します。

フジミはこれらコア技術を組合せ、様々な用途向けの研磨材を開発、製造、販売しています。

研磨対象用途の具体例

<ハードディスク> パソコン等の記憶装置であるハードディスクでは、磁気ディスクが高速で回転し、磁気ヘッドでデータを読み書きします。高速で安定したデータの読み書きには、ディスクとヘッドの距離がわずか10万分の1mm程度であることが要求されるため、磁気ディスクには高度な平坦性と表面欠陥が無いことが求められ、研磨スラリー（液体研磨材）を用いた精密加工が施されます。

<シリコンウェハ> 半導体デバイス用シリコンウェハ基板には微細配線が施されます。データ処理容量、能力等はその配

線間隔に依存するため、年々細線化が進み現在ではその配線間隔が10ナノメートル台となっております。この要求に応えるにはウェハ基板に対し①平坦性、②平滑性、③無欠陥、④無汚染が求められ、研磨スラリーを用いた精密加工が施されます。

精密研磨技術：フジミの研磨スラリー

研磨スラリーは、シリコンウェハの精密研磨に用いられるのみならず、半導体デバイスの多層配線の平坦化(CMP*)にも使用されます。

研磨材(スラリー)は、研磨を促進するケミカル薬剤及び砥粒に加え、過度の研磨を抑制したり研磨加工性を最適化するための表面保護剤、更には研磨スラリーの物理的、化学的安定性に寄与する各種添加剤等から構成されています。

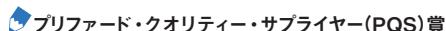
近年の高度な要求に応えるには研磨スラリーの各構成成分の独自設計及び配合や改良が重要で、ここにフジミのオリジナリティの高い設計技術とその製品化を可能とする生産技術が力を発揮します。

フジミの精密研磨材は、まさに超微細加工の必需品なのです。シリコンウェハやCMPで使用されるフジミの精密研磨材の技術力の高さは、世界最大の半導体メーカーであるインテル社から2014年度、2015年度と2期連続でプリファード・クオリティー・サプライヤー(PQS)賞*を受賞したことでも証明されています。

意外な所で使われているフジミの製品



Chemical Mechanical Planarization 又は Chemical Mechanical Polishing の略。薬液の化学的作用と砥粒の機械的研磨作用により半導体デバイスの多層配線を平坦化する技術。



品質、コスト、供給体制、技術力、顧客サービス、労務・倫理システムならびに環境持続性により評価されるすべての重点項目に対して、業界を先導する重要な役割を果たしたとの評価。

暮らしの中にあるさまざまな商品に使用されているフジミの製品

電子部品（スマートフォンの場合）

※イラストはイメージです。



スマートフォンの内部の例

水晶振動子*部分

ラッピング材(当社製品:FO、A、PWA[アルミナ*]/GC[炭化ケイ素])
ポリッシング材(当社製品:COMPOL
[コロイダルシリカ*スラリー])などが使われています。

半導体デバイス(CPU、メモリなど)

ラッピング材(当社製品:FO)
ポリッシング材(当社製品:GLANZOX、PLANERLITE
[コロイダルシリカスラリー])などが使われています。



FO



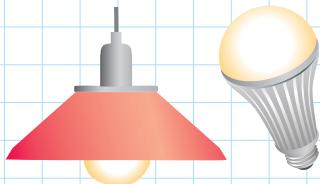
COMPOL



GLANZOX

LED照明

LED照明に使われるサファイア基板にGC、C、WA、COMPOLなどが使われます。



※イラストはイメージです。



GC



WA



COMPOL

アルミナ

粒子径が0.3~3.0 μ m程度の粒子状の酸化アルミ。

コロイダルシリカ

粒子径が10~300nmの粒子状の二酸化ケイ素。

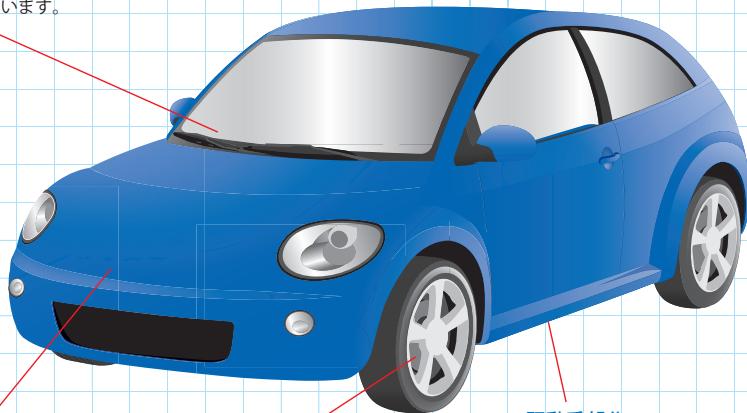
水晶振動子

高い周波数精度の発振を起こす際に用いられる受動素子。

自動車

内装部分

インパネ周りの金属品加工にラッピング材
(当社製品：FO、A、PWA/GC)などが
使われています。



ボディ部分

塗装前、塗装後のボディ研磨の
研磨布紙原料としてラッピング材
(当社製品：FO、A、PWA/GC、C
[炭化ケイ素])が使われています。

ブレーキパッド部分

エンジンシリンダー、ドライブシャフト、
ブレーキパッドのフィラー材(充填材)
に(当社製品：WA[アルミナ]/C)など
が使われています。

駆動系部分

エンジンシリンダー、ドライブシャフト、
ギア、ベアリング、燃料ポンプ部品を
研磨する砥石用原料としてラッピング材
(当社製品：FO、A、PWA/GC)などが
使われています。

※イラストはイメージです。



FO



A, WA



GC, C

各種レンズ

ガラスレンズの研磨にはFO、A、PWAなどが使われます。プラスチックレンズには、POLIPLAが使われます。



※イラストはイメージです。



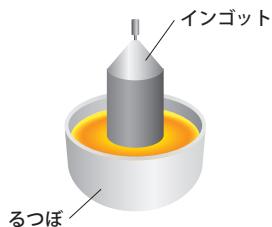
A



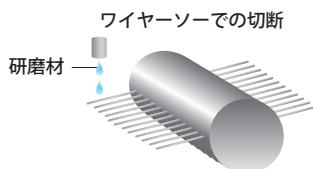
POLIPLA

フジミの製品が使用される半導体工程

インゴット引き上げ



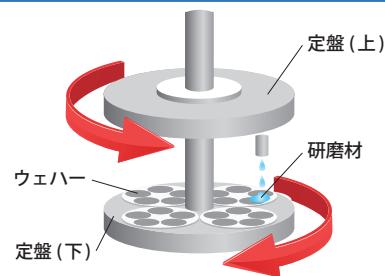
シリコンインゴットの切断



① フジミの研磨材はココで使われます。

単結晶シリコンインゴットをウェハーにスライスします。

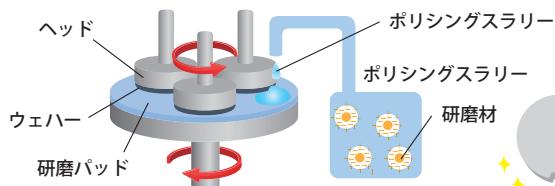
ラッピング工程



② フジミの研磨材はココで使われます。

シリコンウェハー表面の粗さを整えます。

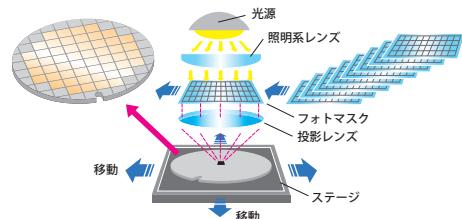
ポリシング工程



③ フジミの研磨材はココで使われます。

シリコンウェハー表面を鏡面状に磨き上げます。

フォトリソグラフィ工程



フォトレジスト(感光剤)をウェハー表面に塗布し、回路パターンが描かれたフォトマスク*をウェハーに焼きつけます。その後、不要な酸化膜やレジストをエッチングして取り除くとパターンの完成です。



GC



FO

半導体素子の基板として使用されるシリコンウェハーは、シリコンの塊(シリコンインゴット)からワイヤーソー*で薄くスライスされたものです。スライス時に使用されるのが、主にGCシリーズです。

その後、スライスされたシリコンウェハーを研磨装置の上に設置し、平らに磨いていく作業がラッピングと呼ばれる研磨工程です。そのときに使用されるのがFOシリーズやPWAシリーズです。

ワイヤーソー

細いワイヤーにダイヤモンドチップ等を埋め込んだ系のこぎり。

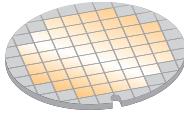
フォトマスク

電子部品の回路パターン等を被転写対象に転写する際の原版。

※イラストはイメージです。
実際の工程とは異なることもあります。

組み立て

デバイスウェハー



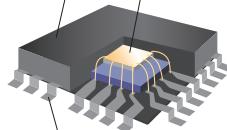
ダイヤモンドソーで
ウェハーを縦横にカット



ダイヤモンドソー

パッケージ

ICチップ

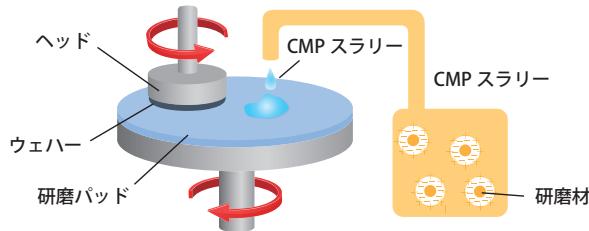


リードフレーム

ウェハーをチップに切り分け、
パッケージングして出荷します。

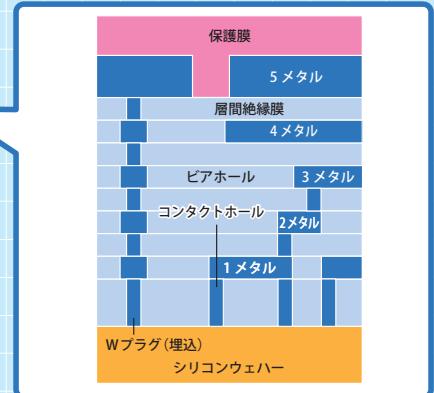
CMP工程

スラリーを流しながら、ヘッドに貼り付け固定されたウェハーの表面を、
研磨テーブル表面の研磨パッドに接触させて研磨します。



④ フジミの研磨材はココで使われます。

堆積された絶縁膜やパターン(配線)の凹凸をCMPによって平坦化します。



この工程を12~14回繰り返し、多層配線を形成
します。

繰り返し



GLANZOX



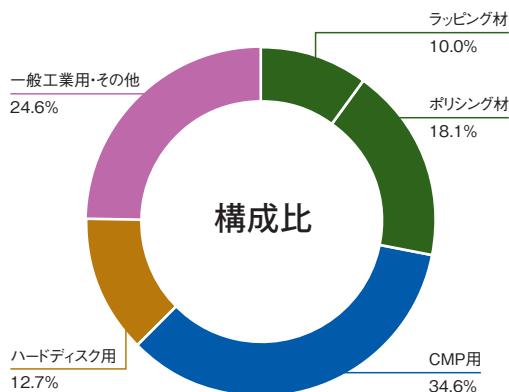
PLANERLITE

さらにシリコンウェハーを鏡面に仕上げるポリシング工程やシリ
コンウェハーの端部分を研磨するために使用されるのがGLANZOX
シリーズです。

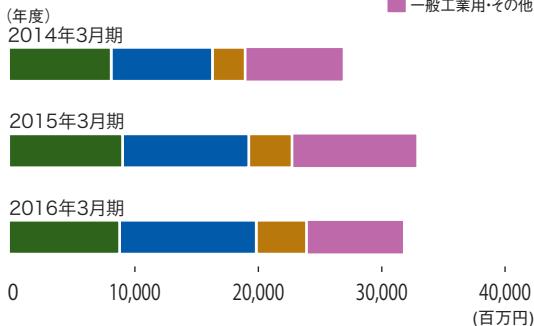
また、近年の半導体素子はウェハー上に回路を多層化し、製造され
ます。回路を積層するためには絶縁膜や配線を平坦化するCMP工程
が必要で、そのときに使用されるのがPLANERLITEシリーズです。

用途別の動き

2016年3月期 用途別売上高構成比



用途別製品 売上高推移



シリコンウェハー用

- 売上高: 8,925百万円
- 前期比: 2.4%減

シリコンウェハー向け製品につきましては、第2四半期連結会計期間以降、半導体需要が前年を下回る状況となったことから、ラッピング材の売上高は3,171百万円(前期比3.2%減)、ポリシング材の売上高は5,753百万円(前期比2.0%減)となりました。

CMP用

- 売上高: 10,980百万円
- 前期比: 8.2%増

CMP向け製品につきましては、アジア市場で最先端ロジックデバイス向け製品及びメモリデバイス向け製品の販売が好調であったことから、売上高は10,980百万円(前期比8.2%増)となりました。

ハードディスク用

- 売上高: 4,041百万円
- 前期比: 16.2%増

ハードディスク向け製品につきましては、ハードディスクドライブ市場は縮小傾向にあるものの、アルミディスク向け製品における当社シェアの拡大により、売上高は4,041百万円(前期比16.2%増)となりました。

一般工業用・ その他

- 売上高: 7,809百万円
- 前期比: 22.3%減

非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、第2四半期連結会計期間以降、当社製品の需要が減退したことから、売上高は5,403百万円(前期比30.6%減)となりました。

その他につきましては、売上高2,406百万円(前期比6.6%増)となりました。

パソコンを中心に、電子・IT関連機器の心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハー（半導体基板）です。このウェハーをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右します。当社グループの主力となるシリコンウェハー用製品では、お客様の期待に応える製品開発をタイムリーに行い、品質の高い新製品をいち早く市場に投入してまいります。



シリコンウェハーは、半導体部品の土台です。現在の主流は、直径が300mmで、表面を高精度に磨き上げるために超精密研磨材が使用されます。

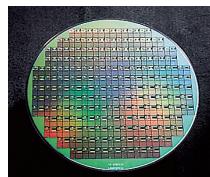


ラッピング材の主力製品
FO



ポリシング材の主力製品
GLANZOX

エレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体チップはますます高集積化・微細化が求められています。CMP（化学的機械的平坦化）用製品群は、長年にわたるシリコンウェハー用ファイナルポリシング材のノウハウを応用し開発され、多層配線技術に対応しています。お客様のロードマップにあった迅速な開発品の提供や技術サービスを核に、マーケットシェアの拡大を目指してまいります。



さまざまな情報通信機器やエレクトロニクス製品の技術進展が加速する中、半導体チップはますます小さく、その配線は細かくなっています。肉眼では見えない細かな配線は12~14層にも積み上げられ、その製造過程において、CMP研磨は欠かすことができません。



CMP用の主力製品
PLANERLITE

ハードディスクは、パソコンの記憶装置、DVDレコーダー、カーナビなどにも搭載されており、最近ではクラウド向けの用途が拡大しています。デジタル家電の高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量のハードディスクの需要が高まり、シリコンウェハー同等の面精度が要求されています。各業界のニーズをいち早くキャッチし、開発期間の短縮化によりお客様の要求にあった新製品をタイムリーに提供してまいります。



写真や映像を手軽に加工したいという市場ニーズが高まり、技術革新が進んだことで、パソコン、デジタルカメラなどのデジタル家電は、より多くの情報が記憶できるようになりました。それに伴い、記憶装置であるハードディスクの研磨面にも今まで以上の高いレベルが求められています。



ハードディスク用の主力製品
DISKLITE

LED・ディスプレイ・パワーエレクトロニクス用部品の表面加工分野やパウダー技術を活かし、応用分野への研磨・研削材の開発にも積極的に取り組んでいます。最近では、新規用途の一般工業用研磨材にも注力しており、トータルソリューションの提供によりお客様の信頼を得ています。

溶射材は鉄鋼、航空機および半導体等さまざまな業界の溶射用途向けに、主にサーメット溶射材とセラミック溶射材を提供しています。



航空機、鉄鋼、発電、掘削、電子部品などさまざまな分野で利用される溶射材。



ファイヤ基板用の主力製品
COMPOL



溶射材の主力製品
SURPREX

連結財務諸表

連結損益計算書

前連結会計年度
(自2014年4月1日
至2015年3月31日)

当連結会計年度
(自2015年4月1日
至2016年3月31日)

売上高	32,815	31,755
売上原価	19,887	19,353
売上総利益	12,927	12,402
販売費及び一般管理費	8,799	9,099
営業利益	4,128	3,302
営業外収益		
受取利息	46	28
為替差益	349	—
廃棄物処分益	44	39
その他	65	29
営業外収益合計	506	97
営業外費用		
為替差損	—	31
固定資産除売却損	30	12
その他	8	14
営業外費用合計	39	58
経常利益	4,596	3,342
特別利益		
新株予約権戻入益	48	—
特別利益合計	48	—
税金等調整前当期純利益	4,645	3,342
法人税、住民税及び事業税	1,287	733
法人税等調整額	△ 338	262
法人税等合計	949	995
少数株主損益調整前当期純利益	3,695	2,346
親会社株主に帰属する当期純利益	3,695	2,346

(単位：百万円)

売上高

世界半導体市場は、これまで成長を牽引してきた中国スマートフォン市場の減速により、第2四半期連結会計期間以降、前年同期を下回る状況となりました。こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めましたが、売上高は前期比3.2%減の31,755百万円となりました。

営業利益

売上減少に加え販売費及び一般管理費の増加により、前期比20.0%減の3,302百万円となりました。

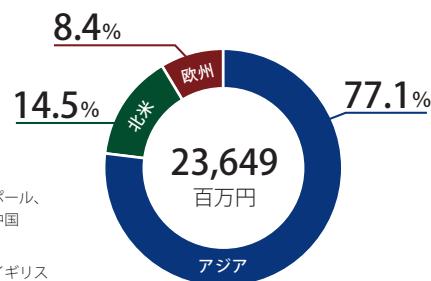
親会社株主に帰属する当期純利益

前期比36.5%減の2,346百万円となりました。

海外売上高構成比 (2016年3月期)

※各区分に属する地域の
主な内訳は次のとおりです。

- アジア：台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国
- 北米：アメリカ、カナダ
- 欧州：ドイツ、イタリア、イギリス



	前連結会計年度 (自2014年4月1日 至2015年3月31日)	当連結会計年度 (自2015年4月1日 至2016年3月31日)
海外売上高		
海外売上高	25,016	23,649
連結売上高	32,815	31,755
連結売上高に占める割合	76.2%	74.5%

(単位：百万円)

連結貸借対照表

前連結会計年度
(2015年3月31日)

当連結会計年度
(2016年3月31日)

資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,390	19,320
受取手形及び売掛金	6,487	6,669
有価証券	4,805	1,999
たな卸資産	5,606	5,383
繰延税金資産	690	448
その他	182	1,713
貸倒引当金	△28	△11
流動資産合計	36,134	35,525
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	7,913	7,341
その他(純額)	6,232	6,338
有形固定資産合計	14,146	13,680
無形固定資産		
無形固定資産合計	710	686
投資その他の資産		
投資有価証券	247	525
繰延税金資産	154	164
その他	522	112
貸倒引当金	△124	△9
投資その他の資産合計	799	793
固定資産合計	15,656	15,159
資産合計	51,790	50,684

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2015年3月31日)

当連結会計年度
(2016年3月31日)

負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,319	2,703
未払法人税等	763	263
賞与引当金	947	785
その他	1,719	1,853
流動負債合計	6,750	5,605
固定負債		
繰延税金負債	13	8
退職給付に係る負債	311	526
その他	20	19
固定負債合計	345	554
負債合計	7,096	6,160
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,753	4,753
資本剰余金	5,038	5,038
利益剰余金	38,836	40,042
自己株式	△5,379	△5,725
株主資本合計	43,248	44,109
その他の包括利益累計額		
その他の包括利益累計額合計	1,446	414
純資産合計	44,694	44,523
負債純資産合計	51,790	50,684

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べて3,622百万円減少し、2,869百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益の減少及び法人税等の支払額の増加により資金の減少があったこと等によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果得られた資金は、1,623百万円となり、前年同期と比べ1,301百万円の増加となりました。これは、定期預金の預入による支出が減少したこと等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べて957百万円増加し、2,644百万円となりました。これは、自己株式取得のための預託金支出が増加したこと等によるものです。

配当金及び連結配当性向の推移

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、経営にあたっております。配当につきましては30%以上の連結配当性向を目標として、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを基本方針としてまいりました。このような方針のもと、当期末配当金につきましては、1株につき20円を予定しております。この結果、中間配当を含めた当期の配当金は、1株につき40円となります。次期につきましては、1株につき中間配当金25円、期末配当金25円とし、年間配当金は50円を予定しております。なお、現在策定中の中長期経営計画において、成長分野への投資を強化するとともに、より一層の株主還元を図ることで、企業価値を持続的に高めるため、将来的には50%以上の連結配当性向とすることを目標として、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを新たな基本方針として掲げることと決定しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度 (自2014年4月1日 至2015年3月31日) 当連結会計年度 (自2015年4月1日 至2016年3月31日)

	前連結会計年度 (自2014年4月1日 至2015年3月31日)	当連結会計年度 (自2015年4月1日 至2016年3月31日)
●営業活動によるキャッシュ・フロー	6,491	2,869
●投資活動によるキャッシュ・フロー	322	1,623
●財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,687	△2,644
現金及び現金同等物に係る換算差額	309	△453
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	5,436	1,394
現金及び現金同等物の期首残高	12,990	18,426
現金及び現金同等物の期末残高	18,426	19,820

(単位:百万円)

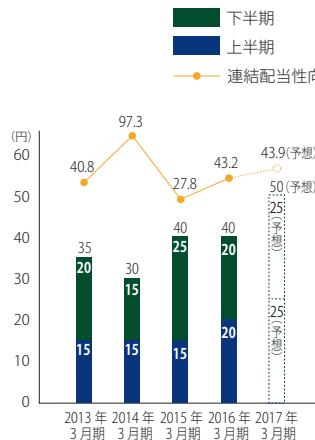
■減価償却費



■設備投資



■配当金及び連結配当性向の推移



■研究開発費・売上高比

折れ線グラフ: 売上高比 (右軸)



株式情報

2016年3月31日現在

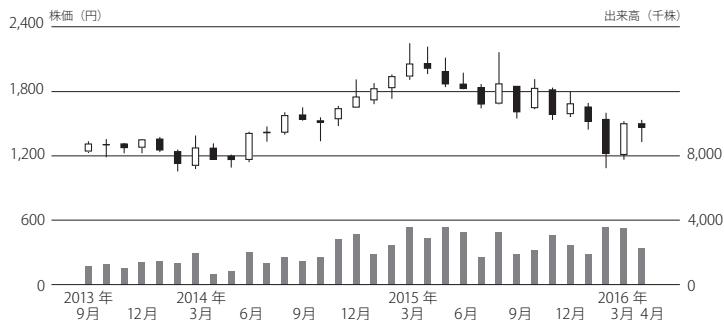
株式の状況

株式数	発行可能株式総数	120,000 千株
	発行済株式総数	29,699 千株
	株主数	7,249 名

大株主 (株主名)	持株数 (千株)	持株比率 (%)
株式会社フジインコーポレーテッド	4,605	15.5
越山 勇	2,902	9.7
有限会社コマ	1,638	5.5
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,278	4.3
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	1,212	4.0
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	728	2.4
株式会社りそな銀行	691	2.3
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-HCR00	655	2.2
フジミ取引先持株会	641	2.1
日本生命保険相互会社	639	2.1

※持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てています。

株価および出来高の推移



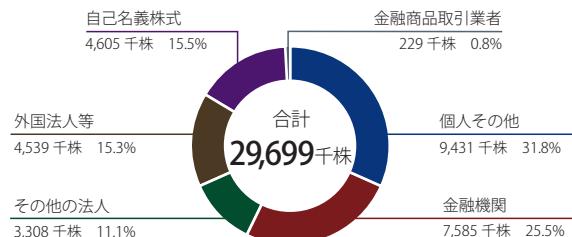
株主分布状況

2016年3月31日現在

298人 (4.1%)



所有者別株主数



所有者別持株数

役員

2016年
6月22日現在

代表取締役社長	関 敬史
常務取締役	伊藤 広一
取締役	鈴木 彰
取締役	大脇 寿樹
取締役	鈴木 勝弘
取締役	川下 政美*
常勤監査役	松島 伸男
常勤監査役	藤川 佳明
監査役	高橋 正彦**
監査役	岡野 勝**

(*印は社外取締役) (**印は社外監査役)

会社データ

2016年3月31日現在

商号	株式会社フジインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1 TEL. 052-503-8181 (代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	4,753百万円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	811名 (単体559名)

株主メモ

2016年3月31日現在

決 算 日	3月31日
基 準 日	3月31日
単 元 株 式 数	100株
公 告 方 法	電子公告 (http://www.fujimiinc.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先 および照会先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711 (通話無料)

各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等
証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。
証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

【ご注意】

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問い合わせください。

特別口座管理機関 連絡先	日本証券代行株式会社 〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 日本証券代行株式会社 代理人部 電話 0120-707-843 (通話無料)
-----------------	---

株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：財務部経営企画課
TEL：052-503-8181 (代表)
URL：<http://www.fujimiinc.co.jp>

Copyright (C) 2016 Fujimi Incorporated. All rights reserved.



この印刷物は、環境負荷低減のため古紙パルプを80%使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。